



OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11) Número de publicación: 2 646 942

21) Número de solicitud: 201630824

(51) Int. Cl.:

H01L 21/027 (2006.01) B81C 1/00 (2006.01)

(12)

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

R1

(22) Fecha de presentación:

17.06.2016

(43) Fecha de publicación de la solicitud:

18.12.2017

(88) Fecha de publicación diferida del informe sobre el estado de la técnica:

25.01.2018

(71) Solicitantes:

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA (100.0%) Jordi Girona, 31 08034 Barcelona ES

(72) Inventor/es:

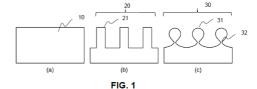
GARIN ESCRIVA, Moises; ALCUBILLA GONZALEZ, Ramon y SOLA GARCIA, Maria Magdalena

54) Título: Procedimiento para la fabricación de resonadores esferoidales sobre un substrato monocristalino.

(57) Resumen:

Procedimiento para la fabricación de resonadores esferoidales sobre un substrato monocristalino.

El procedimiento comprende realizar, mediante la utilización de al menos una técnica litográfica y de grabado, una matriz de pilares (20) sobre la superficie de un substrato monocristalino (10); y reorganizar en fase sólida, dicha matriz de pilares (20) por difusión superficial mediante un proceso de recocido a alta temperatura, igual o por encima de 1000°C, proporcionando un número predeterminado de esferoides (31), en correspondencia al número de pilares (21), que están unidos al substrato monocristalino (10) por un cuello.





(21) N.º solicitud: 201630824

22 Fecha de presentación de la solicitud: 17.06.2016

32 Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

(5) Ir	nt. Cl. :	H01L21/027 (2006.01						
		B81C1/00	(20	06.01)			

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	66	Documentos citados	Reivindicaciones afectadas				
Y	WELL-ORDERED, HIGH-ASPECT OVER LARGE AREAS USING BL Thin Solid Films, 20060814 Elsevi NL. Radamson Henry; Ruzin Arie, 513, Nº 1-2, Páginas 289 - 294, IS	Gowrishankar V et al FABRICATION OF DENSELY PACKED, WELL-ORDERED, HIGH-ASPECT-RATIO SILICON NANOPILLARS DVER LARGE AREAS USING BLOCK COPOLYMER LITHOGRAPHY. Thin Solid Films, 20060814 Elsevier, AMSTERDAM, NL. Radamson Henry; Ruzin Arie, 14/08/2006, Vol. 513, Nº 1-2, Páginas 289 - 294, ISSN 0040-6090, CDOI: doi:10.1016/j.tsf.2006.01.064>. Todo el documento.					
Y	FOR 3-D PROFILE TRANSFORM AND SIDEWALL ROUGHNESS R SYSTEMS, 20060401 IEEE SERV Vol. 15, N° 2, Páginas 338 - 343, I	NG-CHANG M et al. THERMAL ANNEALING IN HYDROGEN D PROFILE TRANSFORMATION ON SILICON-ON-INSULATOR DEWALL ROUGHNESS REDUCTION. JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL MS, 20060401 IEEE SERVICE CENTER, US. 01/04/2006, N° 2, Páginas 338 - 343, ISSN 1057-7157, loi:10.1109/JMEMS.2005.859092>. Página 341.					
A	ELECTROLESS-PLATED FILMS. AND TECHNOLOGY: PART B, 20 NEW YORK, NY, US. 28/05/2010,	HERMAL TRANSFORMATION OF JOURNAL OF VACUUM SCIENCE 100528 AVS / AIP, MELVILLE,	1-7				
X: d Y: d r	egoría de los documentos citados e particular relevancia e particular relevancia combinado con o nisma categoría efleja el estado de la técnica	O: referido a divulgación no escrita tro/s de la P: publicado entre la fecha de prioridad y la de p de la solicitud E: documento anterior, pero publicado después de presentación de la solicitud					
	presente informe ha sido realizado para todas las reivindicaciones	para las reivindicaciones nº:					
Fecha	de realización del informe 12.01.2018	Examinador S. Sánchez Paradinas	Página 1/6				



(21) N.º solicitud: 201630824

22 Fecha de presentación de la solicitud: 17.06.2016

32 Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

(5) Int. Cl.:	H01L21/027 (2006.01) B81C1/00 (2006.01)				
---------------	---	--	--	--	--

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	66	Reivindicaciones afectadas		
А	Zheng Fan et al. SPHERES ON PI BASED ON ATTOGRAM MASS DI NANOTUBES. Nanotechnology (IE IEEE Conference on, 20100817 IE USA. 17/08/2010, Páginas 649 - 68	1-7		
A Chang Y F et al. HIGH-DENSITY N RESISTIVE SWITCHING MEMORY TO FABRICATE A ONE DIODE - O ARCHITECTURE. Proceedings of 3 2014 International Symposium on V Systems and Application (VLSI-TSA		Y USING NANO-SPHERE LITHOGRAPHY DNE RESISTOR (1D-1R) Technical Program - VLSI Technology,	1-7	
X: d Y: d r	regoría de los documentos citados le particular relevancia le particular relevancia combinado con ot misma categoría efleja el estado de la técnica	O: referido a divulgación no escrita ro/s de la P: publicado entre la fecha de prioridad y la de pr de la solicitud E: documento anterior, pero publicado después o de presentación de la solicitud		
	presente informe ha sido realizado para todas las reivindicaciones	para las reivindicaciones nº:		
Fecha	de realización del informe 12.01.2018	Examinador S. Sánchez Paradinas	Página 2/6	

INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA Nº de solicitud: 201630824 Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) H01L, B81C Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados) INVENES, EPODOC, NPL

OPINIÓN ESCRITA

Nº de solicitud: 201630824

Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 12.01.2018

Declaración

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)

Reivindicaciones 1-7

SI
Reivindicaciones NO

reminidadiones

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones SI

Reivindicaciones 1-7 NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinión.-

La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.

Nº de solicitud: 201630824

1. Documentos considerados.-

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la realización de esta opinión.

Documento	Fecha Publicación	
D01	Gowrishankar V et al FABRICATION OF DENSELY PACKED, WELL-ORDERED, HIGH-ASPECT-RATIO SILICON NANOPILLARS OVER LARGE AREAS USING BLOCK COPOLYMER LITHOGRAPHY. Thin Solid Films, 20060814 Elsevier, AMSTERDAM, NL. Radamson Henry; Ruzin Arie, Vol. 513, Nº 1-2, Páginas 289 - 294, ISSN 0040-6090, <doi: doi:10.1016="" j.tsf.2006.01.064=""></doi:>	14.08.2006
D02	LEE MING-CHANG M et al. THERMAL ANNEALING IN HYDROGEN FOR 3-D PROFILE TRANSFORMATION ON SILICON-ON-INSULATOR AND SIDEWALL ROUGHNESS REDUCTION. JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS, 20060401 IEEE SERVICE CENTER, US. Vol. 15, № 2, Páginas 338 - 343, ISSN 1057-7157, <doi: doi:10.1109="" jmems.2005.859092=""></doi:>	01.04.2006

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

REIVINDICACIÓN 1

La presente solicitud se refiere a un procedimiento de fabricación de resonadores esferoidales sobre un sustrato monocristalino que, según la reivindicación principal, comprende dos etapas:

- Realizar una matriz de pilares sobre la superficie del sustrato mediante la utilización de una técnica litográfica
- Reorganizar en fase sólida la matriz de pilares por difusión superficial mediante un proceso de recocido a alta temperatura, igual o por encima de 1000°C, para dar lugar a los esferoides.

El objeto de la **reivindicación principal** se considera que **no implica actividad inventiva** por resultar del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

El **documento D01** representa el estado de la técnica más cercano al objeto de la primera reivindicación, y describe un procedimiento para la fabricación de nanopilares de silicio utilizando una técnica litográfica.

Sin embargo, en D01 no se reorganiza la matriz de pilares en una etapa posterior de recocido a alta temperatura. El efecto técnico que se deriva de esta etapa de recocido es la reorganización de la microestructura, y el problema técnico que se resuelve es la formación de estructuras esferoidales a partir de estructuras cilíndricas.

Es conocido del estado de la técnica que el tratamiento térmico a altas temperaturas o "annealing" de estructuras cilíndricas tipo pilar, da lugar a la formación de estructuras esferoidales.

Por ejemplo, el **documento D02** describe cómo hacer estructuras esferoidales a partir de microestructuras de silicio, utilizando *un proceso de recocido a alta temperatura, igual o por encima de 1000°C* (página 341, columna 1, líneas 9-14; figura 7b) para dar lugar a los esferoides, en correspondencia al número de pilares, que permanecen unidos al substrato monocristalino.

Se considera que el experto en la materia, enfrentado al problema técnico objetivo mencionado, hubiera recurrido a las enseñanzas del documento D02 ya que es del mismo campo técnico y aborda el mismo problema, consistente en formar estructuras esferoidales a partir de cilíndricas.

Por lo tanto, el experto en la materia hubiera añadido, siguiendo las enseñanzas de D02, una etapa de recocido a alta temperatura al procedimiento de D01 con el objeto de solucionar el problema técnico objetivo planteado, sin que se produzca ningún efecto técnico inesperado, llegando así de forma obvia a un procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1.

En conclusión, se considera que la **reivindicación 1 carece de actividad inventiva** frente a la combinación de documentos D01 y D02 (artículo 8.1 Ley de Patentes).

OPINIÓN ESCRITA

Nº de solicitud: 201630824

Las **reivindicaciones dependientes 2-7** añaden una serie de características opcionales y teóricamente consideradas no esenciales. Estas reivindicaciones no contienen características adicionales que, en combinación con las de la reivindicación principal de la que dependen, supongan actividad inventiva con respecto a la combinación de los documentos D01 y D02 por las siguientes razones:

En D01 se describe la modificación de las dimensiones de los pilares en función del cambio en los parámetros del proceso litográfico. Las características de las **reivindicaciones 2-5 se consideran faltas de actividad inventiva** pues serían una opción de diseño obvia para un experto en la materia.

La característica de la **reivindicación 6 se considera falta de actividad inventiva** ya que se anticipa en D02 (página 341, columna 1, líneas 12-14).

La característica de la reivindicación 7 se considera también falta de actividad inventiva ya que se anticipa en D01.

CONCLUSIÓN

Las reivindicaciones 1	a 7	no pare	cen cump	ir el r	equisito	de activi	dad in	nventiva	frente a	l estado	de la	técnica	anterior,	, según
el artículo 8.1 Ley de F	Pate	ntes.												